



SUN.KING TECHNOLOGY GROUP LIMITED

賽晶科技集團有限公司 | 追求卓越 共贏未來



赛晶科技 2022年中期业绩



A blue-tinted image showing a microchip being processed on a circular wafer.

1

业绩回顾



	2022年1月-6月	2021年1月-6月
销售收入	420,042	490,784
销售收入同比	-14.4%	-28.6%
毛利率	27.5%	25.8%
归属母公司净利	-7,149	-10,957
扣非后归母净利润	-18,432	-10,545
基本每股收益(人民币：分)	-0.44	-0.67
净资产收益率ROE	-0.6%	-0.7%
资本开支	38,384	133,853
经营回款*	345,859	492,395
经营活动产生的现金流量净额	13,954	239,045

*注：经营回款包含预收账款

	2022年06月30日	2021年12月31日
总资产	2,394,504	2,377,141
净资产	1,786,274	1,799,553
资产负债率	25.4%	24.3%
流动比率	3.8	4.2
应收账款净值	726,614	600,272

单位：千元人民币

2022年1月-6月

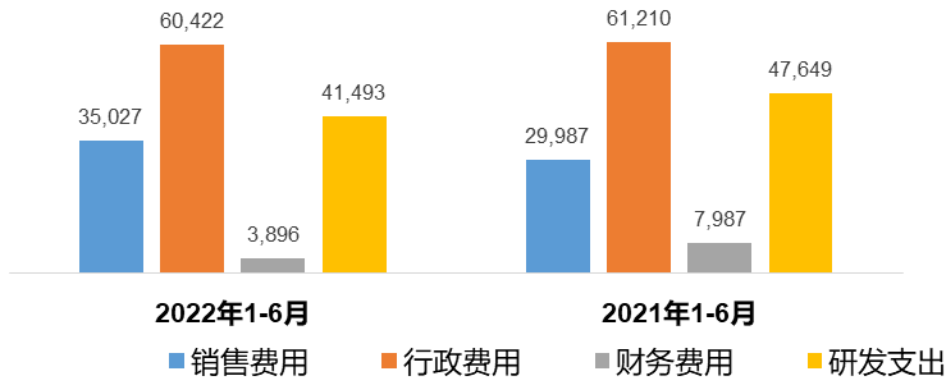
2021年1月-6月

	金额	销售收入占比	金额	销售收入占比
销售费用	35,027	8%	29,987	6%
行政费用	60,422	14%	61,210	12%
财务费用	3,896	1%	7,987	2%
研发支出*	41,493	10%	47,649	10%

*注：研发支出，包括用于研发的资本化支出和费用化支出

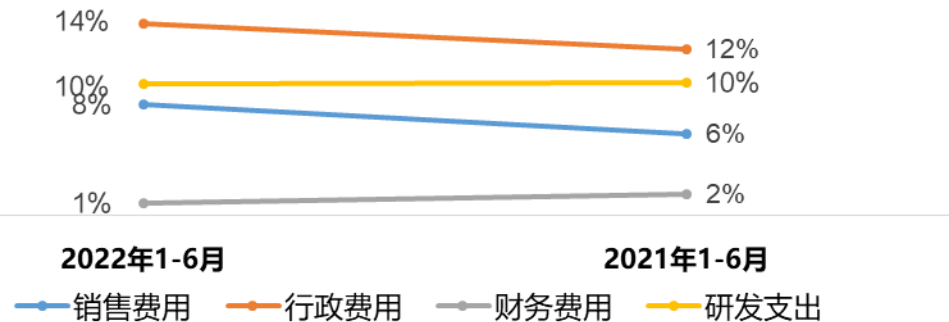
单位：千元人民币

营运费用



单位：千元人民币

营运费用占销售收入比例



IGBT项目	2022年 1月-6月	2021年 1月-6月
销售收入	15,297	--
研发支出*	16,645	16,355
其他费用	14,041	7,332
费用小计	30,685	23,688
资本性支出	27,700	99,087
支出合计	58,386	122,775

*注：研发支出，包括用于研发的资本化支出和费用化支出

	2022年 1月-6月	2021年 1月-6月
归属于母公司净利润 - 扣除IGBT项目	12,667	2,197
归属于母公司净利润 - 包含IGBT项目	-7,149	-10,957

单位：千元人民币

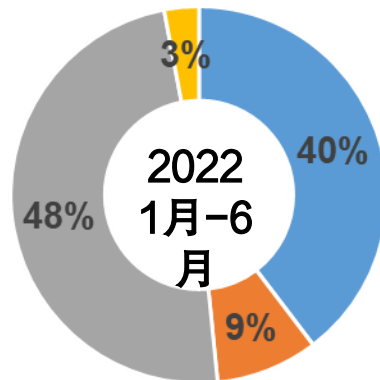
A blue-tinted image showing a microchip being processed on a circular platform, with a large white circle containing the number 2 overlaid on the right side.

2

业务回顾

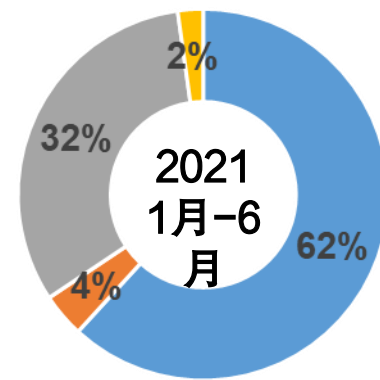


各领域业务 销售收入占比



2022年1月-6月

- 电网输配电
- 电气化交通
- 工业及其他
- 国外市场



2021年1月-6月

		2022年1月-6月		2021年1月-6月	
		销售收入	毛利率	销售收入	毛利率
国内市场	电网输配电	166,499	35.7%	303,369	27.7%
	电气化交通	36,908	12.9%	18,792	23.7%
	工业及其他	204,117	22.0%	157,748	21.0%
	国内市场 合计	407,524	26.8%	479,909	25.4%
国外市场	国外市场 合计	12,518	52.3%	10,875	46.3%
综合销售收入		420,042	27.5%	490,784	25.8%

单位：千元人民币

高压直流输电

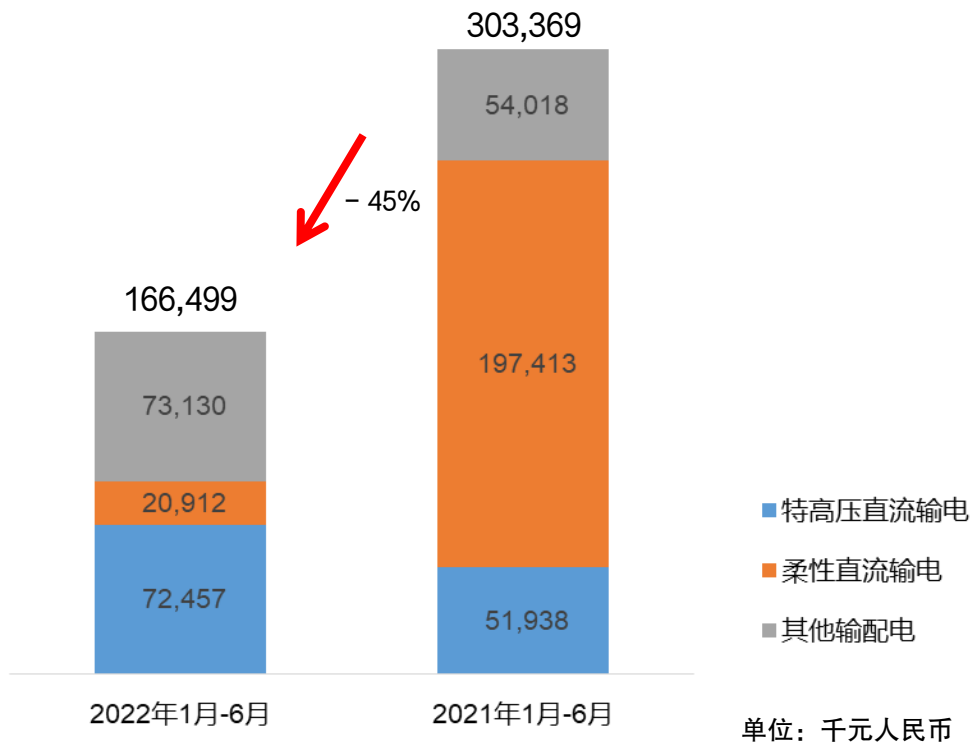
随着“碳达峰、碳中和”战略目标，和构建以新能源为主体的新型电力系统的提出，对清洁能源外送具有重要作用的特高压直流输电和柔性直流输电，得到了高度重视和重点发展。

2022年上半年，特高压直流输电方面，主要交付了“白鹤滩-浙江”特高压直流输电项目订单；柔性直流输电方面，主要交付了220千伏中埠-亭山柔性低频输电示范项目订单。

多个规划中的高压直流输电项目尚未启动，特别是柔性直流输电的订单大幅减少，导致本集团在该领域的总销售收入，较去年同期大幅下降。其中，特高压直流输电领域销售收入为72,457千元人民币，较2021年同期增长40%；柔性直流输电领域销售收入为20,912千元人民币，较2021年同期下降89%。

其他输配电

2022年上半年，源于本集团智能电网在线监测及电力电容器，在智能电网、国家电网集中招标采购中取得了良好成绩。本集团于该领域的销售收入为73,130千元人民币，较2021年同期增长35%。



轨道交通

本集团向中国中车股份有限公司及其下属公司等轨道交通车辆装备制造企业提供多种电力电子器件。此外，本集团亦向轨道交通供电系统提供电能质量治理装置、电气化铁路自动过分相智能开关等多种电力电子装置。

2022年上半年，本集团于该领域销售收入为21,552千元人民币，较2021年同期增长19%。

电动汽车

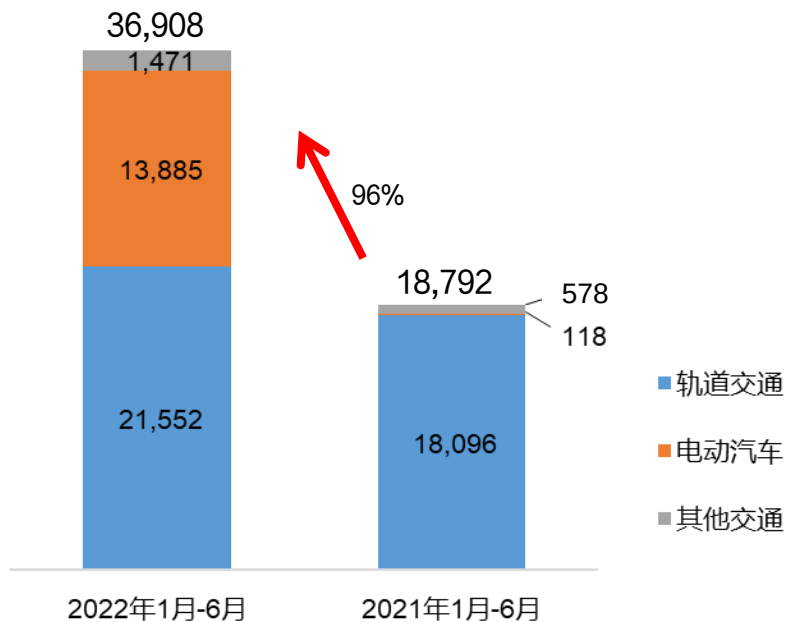
本集团向电动汽车领域提供自主技术IGBT、层叠母排等产品。

2022年上半年，受益于自主研发 i20 IGBT芯片、ED封装IGBT模块批量交付，本集团于该领域销售收入为13,885千元人民币，较2021年同期大幅增长。

其他交通

本集团向国内的船舶、航空等领域提供多种电力电子器件和装置产品。

由于该领域的业务处于开拓期，项目和订单波动性较大。2022年上半年，本集团于该领域销售收入为1,471千元人民币，较2021年同期增长154%。



单位：千元人民币

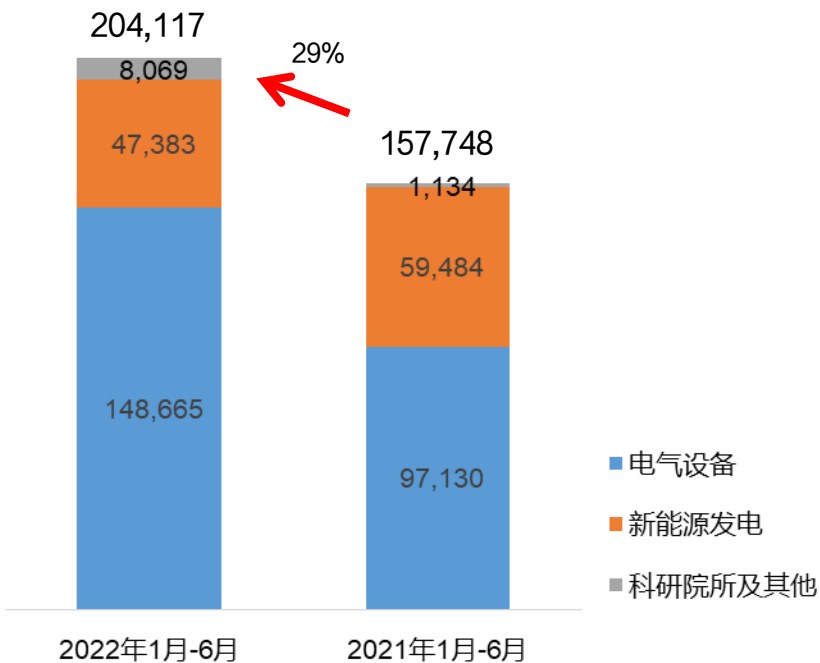
工业及其他

本集团向各类工业领域的电气控制和节能装备制造行业、新能源发电装备制造行业，以及科学研究领域提供各类电力电子器件和装置。

2022年上半年，服务于“双碳”战略目标和新型电力系统构建的新能源发电领域和电气设备领域的市场形势良好。另一方面，上半年由于新冠疫情多发，也对本集团下游行业的生产和经营造成一定负面影响。

2022年上半年，本集团在电气设备领域表现良好，销售收入增长至148,665千元人民币，较2021年同期增长53%。

此外，由于受部分分销产品货期延长影响，上半年本集团在新能源发电领域销售收入减少至47,383千元人民币，较2021年同期下降20%。



单位：千元人民币

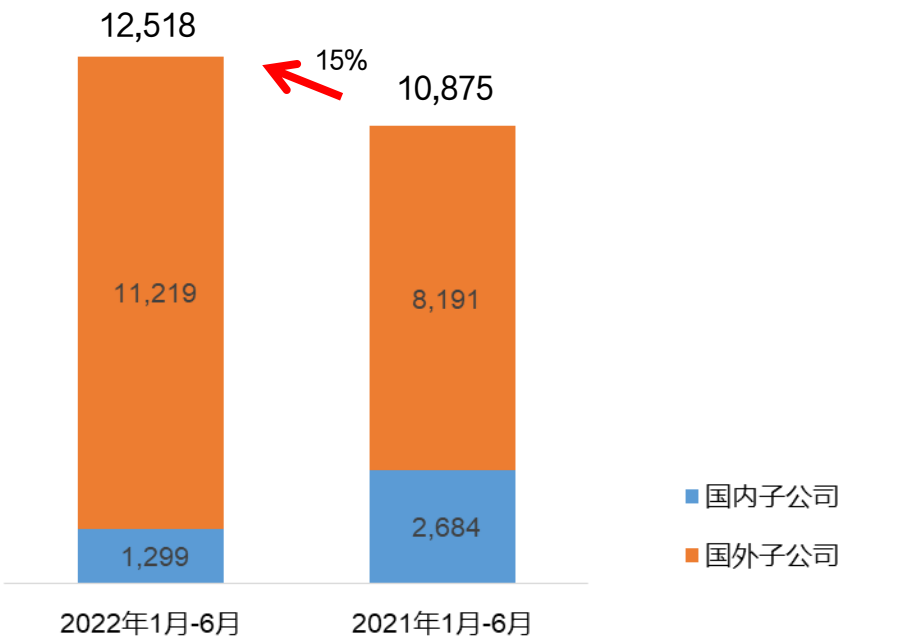
国外市场

本集团国内及国外子公司积极开拓国外市场，面向国外客户销售本集团各类电力电子器件和装置产品，主要的产品包括：

国内子公司 – 层叠母排

国外子公司 – 固态交/直流开关、脉冲电源、阻抗测量

2022年上半年，海外市场的销售收入总额为12,518千元人民币，较2021年同期增长15%。



A blue-tinted image showing a microchip being processed on a circular platform, with a large white circle containing the number 3 overlaid on the right side.

3

业务展望



重点业务（一）：高压直流输电 相关业务

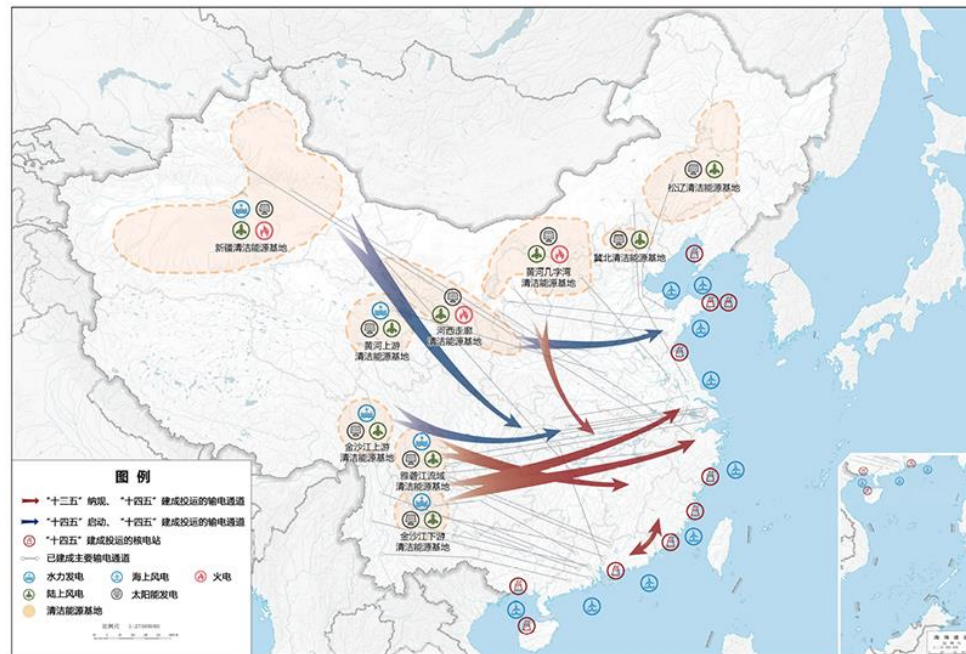
■ 直流输电项目储备充足，2022年下半年有望逐步启动

2022年下半年有望启动的项目

- 国家电网在重大项目建设推进会议上表示，2022年下半年，加大“三交九直”特高压等前期工作力度。力争年内核准开工4个特高压直流等工程：金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆。
- 技术升级改造：葛洲坝—上海（改造为混合直流）
- 柔性直流：三峡阳江青州（三、四）海上风电柔性直流输电工程

规划中的后续项目

- 特高压（常规）直流：除上述项目外，“三交九直”还包括：陕西—安徽、陕西—河南、蒙西—京津冀、甘肃—浙江、藏电送粤直流。
- 柔性直流：粤澳互联、阳江青州（五、七）海上风电



十四五，大型清洁能源基地布局及跨区域能源输送示意图



重点业务（二）：自研IGBT业务 - 芯片

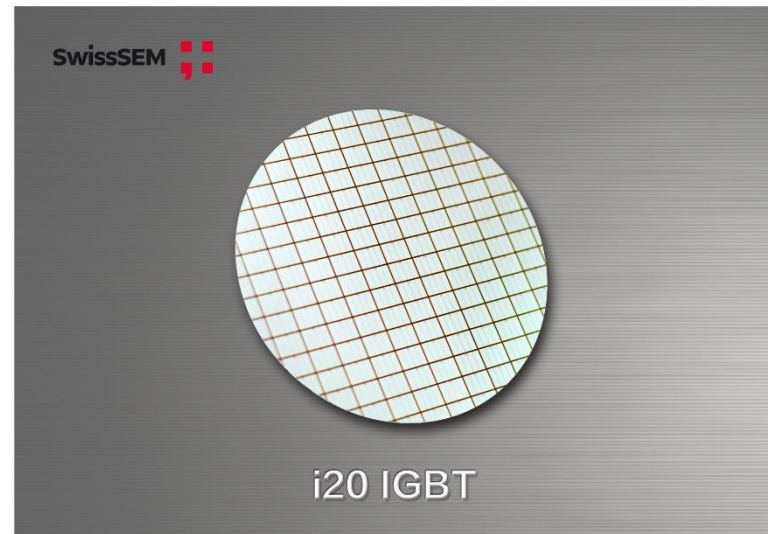
赛晶，致力于为广大业内伙伴提供优秀的国产IGBT芯片，打破国内严重依赖进口芯片的“缺芯”困局，共建国产IGBT良性发展生态圈。

■ 2022年上半年，市场推广取得出色成绩

- 1200V i20 IGBT芯片，已经为面向电动汽车和工控领域的多家客户批量供货。

■ 2022年下半年，重点加强新产品研发

- 完成 1700V i20 IGBT芯片 研发
- 推进 750V 微沟槽技术 i21 IGBT芯片 研发
- 启动 1200V SiC技术 m2x MOSFET芯片 研发



重点业务（二）：自研IGBT业务－模块

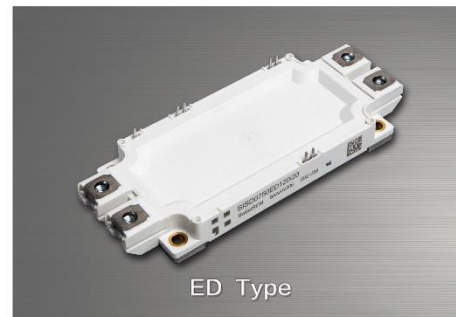
面向实现“双碳”战略目标具有重要意义的电动汽车、新能源发电、工业电控等领域，提供具有国际品质的600V至1700V中压IGBT模块系列产品。

■ 2022年上半年，市场推广取得出色成绩

- 完成1200V/750A、600A等ED封装IGBT模块，于多家电动汽车、新能源发电、工业电控领域客户的测试验证，并完成共计近2万个模块的批量供货。

■ 2022年下半年，继续推进产品研发和市场推广。

- 推进 1200V ED封装IGBT模块的市场推广和批量供货。
- 完成 1200V ST封装IGBT模块 和 HEEV封装SiC模块的研发，随后开始送样测试。
- 完成 1700V ED封装IGBT模块研发，随后开始送样测试。
- 推进 第二条模块生产线的建设，力争在2023年初建成。



A blue-tinted image showing a microchip being processed on a circular platform, with a large white circle containing the number 4 overlaid on the right side.

4

问答环节





SUN.KING TECHNOLOGY GROUP LIMITED
賽晶科技集團有限公司

感谢聆听



賽晶官方网站



賽晶微信公众号

